

NIKAFLEX®

型式 Model **C NS Y** フレキシブルプリント配線板用カバーレイ C-series
Polyimide film base coverlay

型式 Model **SA FY** 多層板用層間接着剤シート SA-series
Adhesive Sheet for Multilayer FPC

特徴 Characteristics

- **比誘電率=2.6 誘電正接 =0.005 (10GHz)** ※接着剤硬化物単体
Dk=2.6, Df=0.005 ※Cured adhesive simple substance
- **片面液晶ポリマー銅張積層板等に対しても高接着**
High adhesion to single-sided liquid crystal polymer copper-clad laminates, etc.
- **160°C/60分多段プレスで基板成型が可能**
Substrate molding is possible with a multi-stage press at 160 ° C / 60 minutes
- **ハロゲンフリー対応、UL94 VTM-0**
Halogen free, UL94 VTM-0

低誘電率・低誘電正接材 標準製品仕様 Low Dk Low Df material, Specifications of standard Products

		型式 Model	
		C NS Y	SA FY
接着剤 Adhesive	種類 Classification	ハロゲンフリー 熱硬化性樹脂 Halogen free / Thermosetting Resin	
	厚さ(μm) Thickness	PI : 12.5μm、AD : 25μm	AD : 25μm
接着剤面の保護材 Releasing Material on Adhesive Surface		剥離紙 Release Paper	剥離PETおよび剥離紙 Release PET and Paper
標準サイズ (mm) Standard Size		500 × Roll(100m)	
推奨成型条件		160°C/4MPa/60min	
保管条件 Storage conditions		5°C以下、80%RH以下 5°C or below and at 80%RH or below	
UL認証 UL Recognition		UL FILE No: E46785	

用途
Usage

適用通信規格例
Communication standard example

基板構成体例
Print circuit board structure example

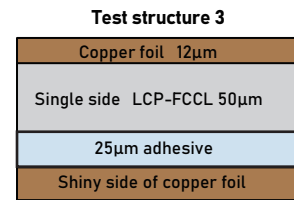
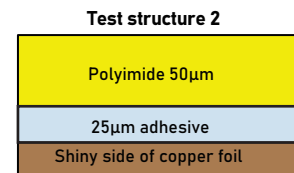
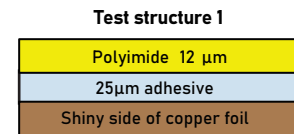
- RF アンテナ基板
RF antenna substrate
- 薄型中継ケーブル
Thin relay cable

- LTE
- Wi-fi
- Bluetooth
- USB3.1
- SATA rev3.0

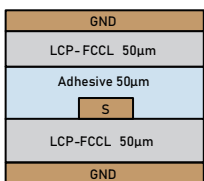
- ストリップライン基板
Strip line circuit
- マイクロストリップライン基板
Microstrip line circuit

伝送損失特性 Insertion loss performance

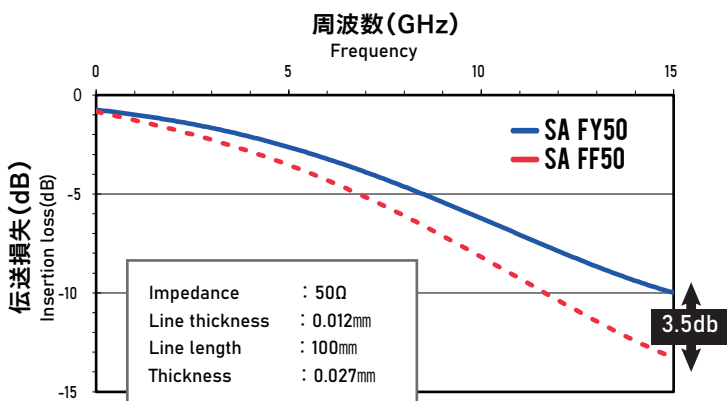
項目 Item	試験方法 Method	試験構成 Test structure	備考 Remark	C NS Y1225	SA FY25
接着剤フロー Resin flow(mm)	当社比 Nikkan method	1	-	0.07	-
引き剥がし強さ Peel strength (N/mm)		1	PI,LCP 90° Peeling	0.7	-
		2		-	1.3
		3		-	1
はんだ耐熱性 Solder resistance (°C)		1	30秒フロート合格 30seconds float test	280	-
		2		-	270
		3		-	250



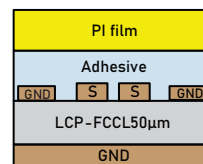
ストリップライン構成 Strip line test structure



項目 Item	周波数 Frequency	SA FY	SA FF
接着剤概要 Adhesive overview	-	低誘電接着剤 Low Dk/Df	汎用接着剤 General material
Dk	10GHz	2.6	3.3
Df	10GHz	0.005	0.028



マイクロストリップライン構成 Micro strip line test structure



項目 Item	周波数 Frequency	C NS Y	C IS V
接着剤概要 Adhesive overview	-	低誘電接着剤 Low Dk/Df	汎用接着剤 General material
Dk	10GHz	2.6	3.3
Df	10GHz	0.005	0.025

